顯像型防焊油墨 Photoimageable Solder Resist Ink

R-500 ZSP 系列 (2 液型 / 液態感光防焊油墨)

R-500 ZSP Series (2 component / liquid photoimageable solder mask)

- (1) 適用於噴塗。
- (2) 具有高解像度及作業性佳。
- (3) 耐化學品性極優。
- (4) 可適用於HDI製程。

- (1) For spray coating.
- (2) High resolution and easy to operation.
- (3) Excellent chemical resistance.
- (4) Suitable for HDI process.

特性(Specification):

項目(Item)	系列名稱(Product name)	R-500 ZSP 系列
顏色 (Color)		各式深淺之綠色、黃色及其它特殊色系 green、yellow and other special colors
硬化劑 (Hardener)		HD-5
混合比率 (Mixing ratio)		主劑 0.80: 硬化劑 0.20 main agent 0.80: hardener 0.20 (by weight)
黏度(混合後) / (岩田 2 號杯) (Viscosity after mixing) / (ANEST IWATA MODEL NK-2)		70∼80 sec.
固成份 (Solid Content)		75∼80 wt%
比重 (混合後) (Density (mixture))		1.3 ± 0.2
最大預烤範圍* (Tack dry window)*		80°C* 50 mins. Max.
曝光量 (能量計: ORC UV351) (Exposure (detector : ORC UV351))		200~400 mJ /cm² (油墨上 / on solder mask)
混合後使用期限 (Pot life)		24 小時 (25℃以下暗處保存) 24 hours after mixing (Stored at dark place , 25℃ or below)
保存期限 (Shelf life)		製造後6個月 (25℃以下暗處保存) 6 months after production (Stored at dark place, 25℃ or below)
項目 (Items)	試驗條件 (Test method)	結果 (Test result)
鉛筆硬度 (Pencil Hardness)	廠內方法 OWI0805-018A	7Н
密著性 (Adhesion)	廠內方法 OWI0805-016A	100 / 100
焊錫耐熱性 (Solder heat resistance)	260°C · 10 sec · 3 cycles	O.K.
耐酸性 (Acid resistance)	10vo1% H2SO4 20°C 20 min	O.K.
耐鹼性 (Alkaline resistance)	10wt% NaOH 20°C 20 min	O.K.
耐溶劑性 (Solvent resistance)	PGM-Ac 20°C 20 min	O.K.
	絕緣電阻 IPC CLASS 3 method sulation resistance) IPC B Pattern	初始值 (Initial):
		$4.9 \times 10^{13} \Omega$
(Insulation resistance)		處理後 (Conditioned):
		$2.6 \times 10^{12} \Omega$
耐燃性 (Flammability)		UL94V-0

^{*}最大預烤範圍:以1% Na₂CO₃、30℃、60秒、2.0Kg/cm²顯影。

^{*}Tack dry window: Developed by 1% Na₂CO₃(aq)、30°C 、60 秒、2.0Kg/cm²。